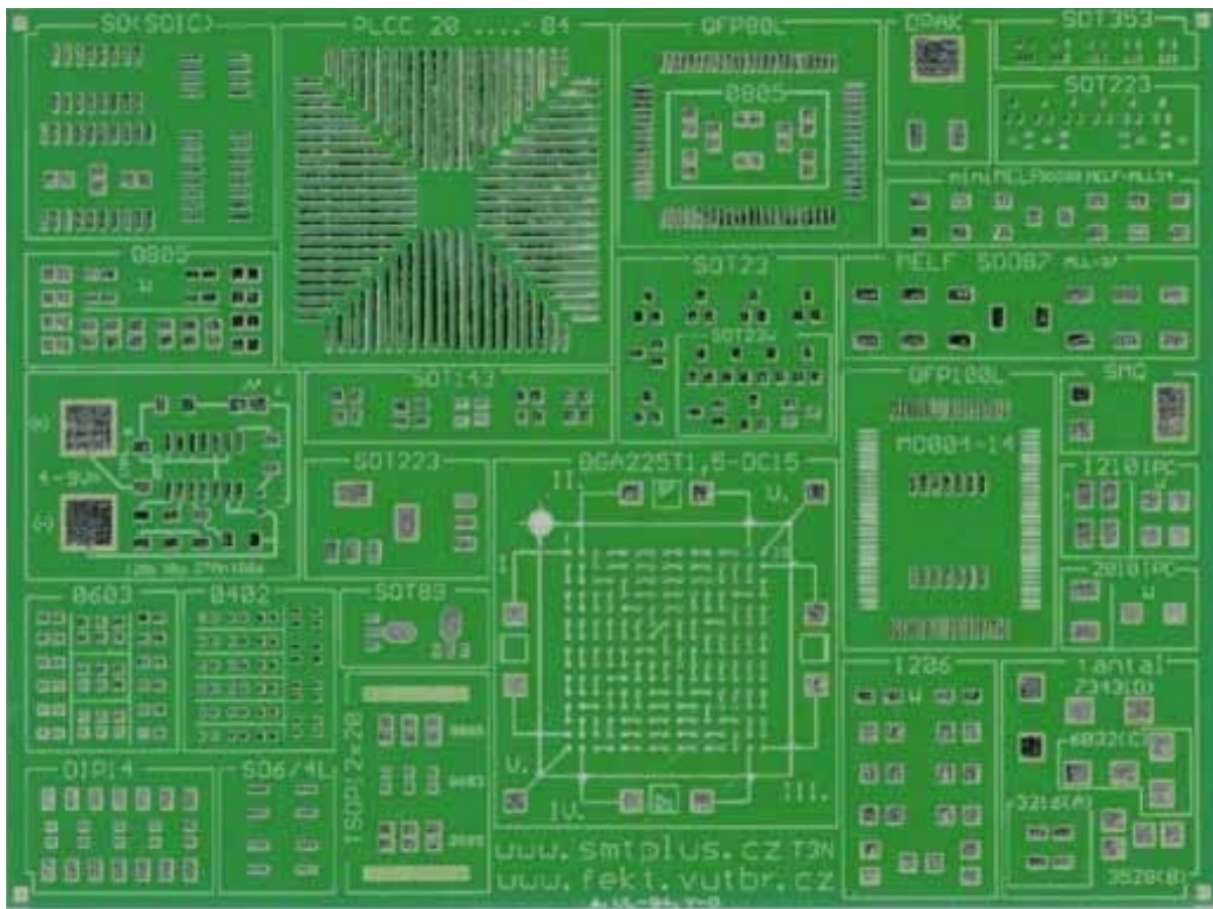


Desky plošného spoje pro trénink pájení (PCB Boards for Solder Training)

Deska T03

Zkušební deska má rozměr 130 x 98mm, je zhotovena z materiálu FR4 tloušťky 1,6mm. Deska je jednostranná. Povrchová úprava je HAL se zelenou nepájivou maskou. Jsou na ní umístěny testovací motivy (footprinty) základních pouzder SMD včetně integrovaných obvodů Flat-Pack a pouzdra BGA. Na desce je umístěno zapojení programovatelné děličky ve funkci jednoduchého blikáče.



Pohled na desku T03

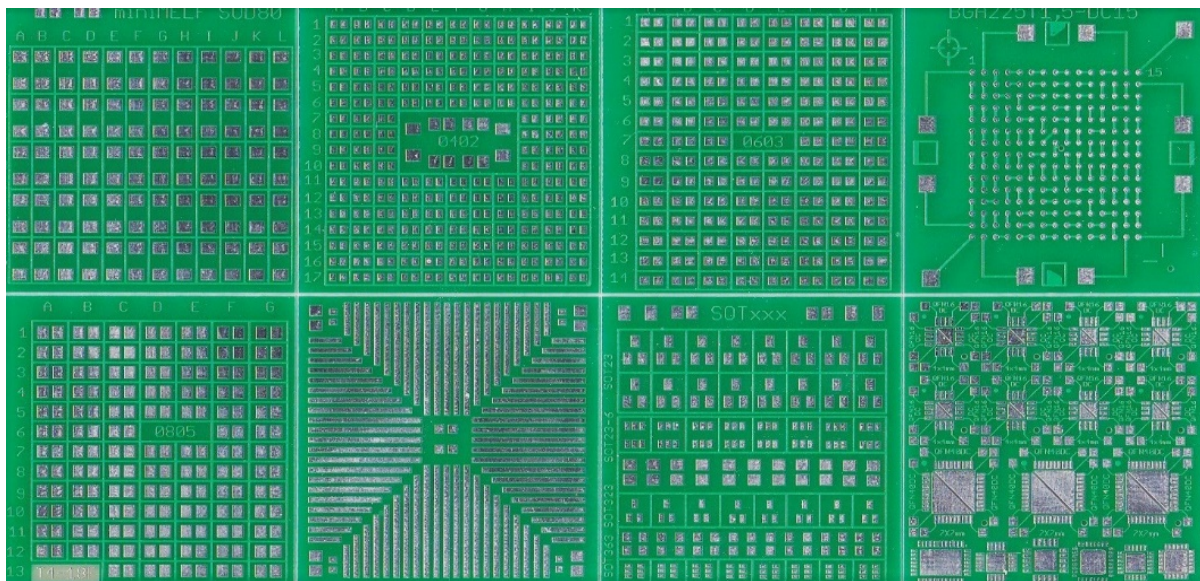
Na desce jsou umístěny footprinty pro následující pouzdra SMD:

- PLCC 20 až 84, QFP80, QFP100, BGA225, MO004-14, TSOP 12x20, SO4 až 20, DIP14, SO6/4, DPAK, SOT23, SOT353, SOT223, SO143, SOT89, 3216(A), 3528(B), 6032(C), 7343(D), mini-MELF, MELF, SOD80, SOD87, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, SMQ
- Na desce je umístěn motiv pro kontrolu pájecího profilu pro pouzdro **BGA225T1.5** s pomocí DUMMY pouzdra **BGA225T1.5 DC15**. Je jím možno diagnostikovat chybné připájení jednotlivých oblastí v poli kuličkových BGA kontaktů.

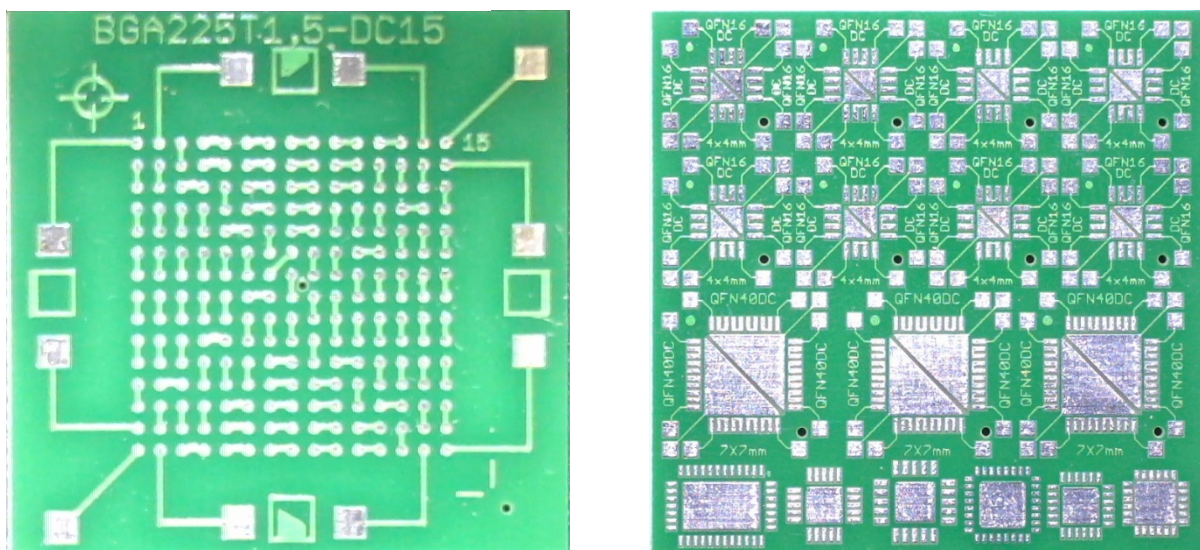
Deska T08

Zkušební deska má rozměr 153 x 75mm, je zhotovena z materiálu FR4 tloušťky 1,6mm. Deska je jednostranná. Povrchová úprava je HAL se zelenou nepájivou maskou. Jsou na ní umístěny testovací motivy (footprinty) základních pouzder SMD, pouzdra BGA a speciální testovací motivy pro pouzdra QFN. Na desce jsou umístěny testovací pole s motivy **mini-MELF (SOD80)**, **0805**, **0402**, **0603**, **PLCC**, **QFN**, **SO (rastr 1.25mm)**, **pouzdra SOT23**, **SOT23-6**, **SOT323**, **SOT363**, **BGA225**, **pouzdra QFN s motivem DC QFN16DC**, **QFN40DC**, a další. Motivы jsou umístěny v samostatných souborech v 8 čtvercích 38 x 38mm, které je možno od sebe oddělit odlomením. Na souborech s IO jsou umístěny otvory pro umístění termočlánků.

K oběma typům desek je možno priobjednat kovovou šablonu pro nanášení pájecí pasty, případně objednat jinou povrchovou úpravu (ENIG).



Celkový pohled na desku T08



Detail na testovací pole desky T08 BGA, QFN